

JPCA 2022 Show

第51回国際電子回路産業展

JIEP マイクロエレクトロニクスショー

第36回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2022

第23回 実装プロセステクノロジー展

SDGs デバイス展  
SDGs デバイス展

WIRE Japan Show  
電気・光伝送技術展

JEP/TEP Show  
JEP 全国電子部品流通連合会  
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile  
イーテキスタイル展

Smart Sensing  
スマートセンシング

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION  
interOpto  
インターオプト

LED JAPAN  
エルイーディージャパン

Imaging Japan  
イメージングジャパン

Edge Computing  
エッジコンピューティング

一步先の未来へ

来て 見て 触れて そして 語ろう!



出展の  
ご案内

2022. 6. 15 Wed. → 6. 17 Fri.

東京ビッグサイト 東2~6ホール

電子機器2022

トータルソリューション展

www.jpccashow.com

申込開始: 2022年1月17日(月) 10:00~



展示会公式サイトへ

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、  
一般社団法人日本ロボット工業会  
共催: 電子デバイス産業新聞 [(株)産業タイムズ社]、電線新聞 [(株)工業通信]、  
(株)JTBコミュニケーションデザイン、  
全国電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合、株式会社社織研新聞社、  
一般財団法人光産業技術振興協会  
後援(予定): 経済産業省

海外協力: 世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体  
中国電子回路行業協会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、印度電子工業会 (ELCINA)、  
香港線路板協会 (HKPCA)、米電子回路協会 (IPC)、印度電子回路工業会 (IPCA)、  
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、タイ電子回路工業会 (THPCA)、  
台湾電路板協会 (TPCA)

2021/12/15版

# 5G/5G+、次世代自動車、通信/インフラ(ネットワーク、再生可能エネルギー、データセンターなど)、ロボット、ウェアラブル、センサー等を具現化する技術の総合展示会

エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、活発な商談の場としてご活用いただいています。

## 開催概要

目的	あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile(ウェアラブル技術)等の新しいコンテンツとソリューション等の展示を加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。
会期	2022年6月15日(水)～17日(金) 午前10時～午後5時
会場	東京ビッグサイト 東2-6ホール
本部事務局	一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA)
運営事務局	株式会社JTBCコミュニケーションデザイン
入場料	1,000円(税込) ※WEB登録で無料

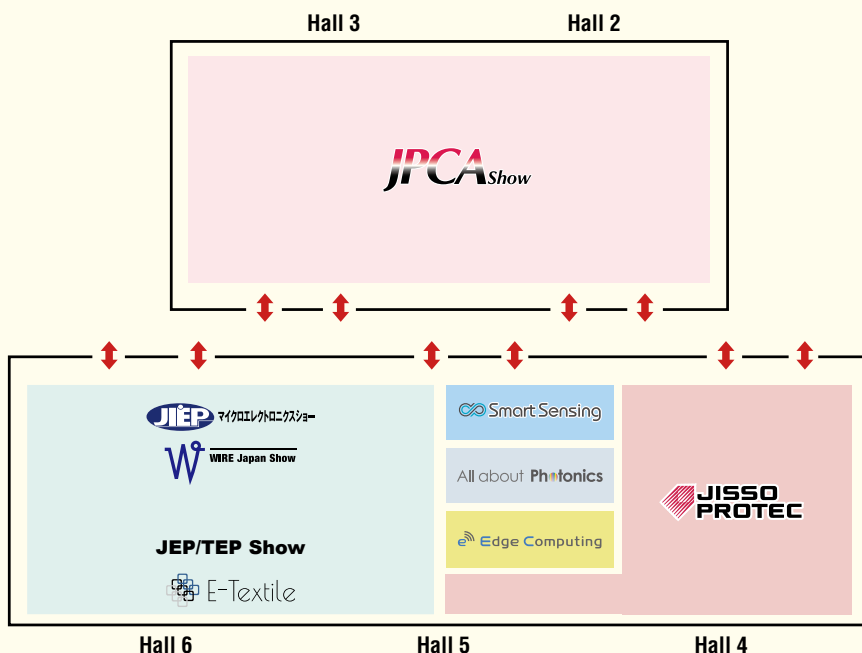
## 2021年開催実績

会場	東京ビッグサイト 南1-3ホール+会議棟		
出展規模	228社 / 411小間	来場者数	16,699名




## 2022年展注目のポイント!

- ① コロナ前の規模(40,000m<sup>2</sup>強)での開催
- ② 小間位置選択制を採用(出展申込順)
- ③ 会期前後の出展効果も強化(ウェビナーの開催・展示会ダイジェストの発行)
- ④ SDGsデバイス展の開催

## 展示会レイアウト案



# ■ 構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術
 <p><b>JPCA Show</b> 第51回国際電子回路産業展</p> <p>●プリント配線板技術展 製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム</p> <p>●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般(製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する技術全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>●機器・半導体受託生産システム展 EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般(製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>主催：一般社団法人日本電子回路工業会</p>	 <p>マイクロエレクトロニクスショー</p> <p>第36回 最先端実装技術・パッケージング展</p> <p>実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)</p> <p>主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会</p>	 <p>第23回 実装プロセステクノロジー展</p> <p>電子部品実装に関する技術全般(電子部品実装機・システム/半導体実装機器・システム/検査技術・システム/実装設計システム/各種ロボット等)</p> <p>主催：一般社団法人日本ロボット工業会</p>

SDGs 具現化技術	電気・光伝送技術	半導体・電子部品	高機能テキスタイル
 <p>SDGs デバイス展</p> <p>・再生可能エネルギー関連エレクトロニクス ・パワーエレクトロニクス関連 実装/材料 ・パワー半導体/パワーデバイス (IGBT、MOSFET、バイポーラトランジスタ等)、各種メモリー(S-RAM、D-RAM、等)、半導体パッケージ、部品内蔵モジュール、メタルコアプリント配線板、熱ソリューション、太陽電池、バッテリー、水素燃料、パワエレ、関連各種デバイス、他</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞(株)産業タイムズ社)</p>	 <p>WIRE Japan Show</p> <p>電気・光伝送技術展</p> <p>ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞(株)工業通信)</p>	 <p>JEP/TEP Show</p> <p>JEP 全国電子部品流通連合会 東京電機卸商業協同組合</p> <p>半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京電機卸商業協同組合</p>	 <p>E-Textile</p> <p>イーテキスタイル展</p> <p>電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社織研新聞社</p>

センサー技術	エッジソリューション技術	All about Photonics		
 <p>Smart Sensing</p> <p>スマートセンシング</p> <p>センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	 <p>Edge Computing</p> <p>エッジコンピューティング</p> <p>低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般 [エッジソリューション応用分野]自動運転システム/工場内機械制御/遠隔医療/AR/VR/スマートシティ/アグリテック/FinTech/無人店舗 等</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	 <p>InterOpto</p> <p>インターオプト</p> <p>レーザー・光源(半導体、ファイバ、超短パルス)/光素子・部品(レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ)/測定装置・光分析機器/生産向けレーザーシステム(レーザー加工装置、マーキング装置)/光情報通信(可視光通信、5G)</p> <p>主催：一般財団法人光産業技術振興協会 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	 <p>LED JAPAN</p> <p>エルイーディージャパン</p> <p>紫外・近赤外LED/LEDパッケージ部材/デバイス・電源/測定・検査・製造装置/光学部品・材料/LED応用最終製品(車載照明、LED可視光通信、医療用照明)</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>	 <p>Imaging Japan</p> <p>イメージングジャパン</p> <p>各種カメラ・センサ機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LIDAR</p> <p>共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン</p>

# ■ 各分野における想定される来場企業

- 自動車関連 アイシン精機、朝日電装、市光工業、カルソニックカンセイ、ケーヒン、KOA、小糸製作所、スタンレー電気、住友電装、ダイハツ工業、デンソー、東海理化、東洋電装、トヨタ自動車、日産自動車、日本発条、パイオニア、日立オートモティブシステムズ、日野自動車、SUBARU、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、矢崎部品
- OA・ロボティクス オムロン、キーエンス、キヤノン、コニカミノルタ、サイバーダイン、山洋電気、JUKI、セイコーエプソン、パナソニック、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ、ファナック、FUJI、富士ゼロックス、三菱電機、安川電機、ヤマハ発動機、リコーインダストリー、リコージャパン
- 情報・通信関連 アップル、インテル、NHKメディアテクノロジー、NTT、NTTドコモ、沖電気工業、韓国放送公社(KBS)、京セラ、KDDI、ソフトバンク、東京放送ホールディングス(TBS)、東芝情報システム、日本IBM、日本電気、日本マイクロソフト、日本ユニシス、パナソニック、PFU、日立製作所、Huawei、フジクラ、富士通、村田製作所
- AV・家電関連 LGエレクトロニクス、カシオ計算機、キヤノン、Samsung Electronics、シャープ、ソニー、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ダイキン工業、ニコン、パイオニア、パナソニック、富士通ゼネラル、ヤマハ、ローランド
- 医療機器関連 オリジナル、Siemens、島津製作所、白河オプティクス、テルモ、東芝メディカルシステムズ、日立ハイテクノロジーズ、日立ヘルスケア・マニュファクチャリング、富士フイルム、マーク電子、モリタ東京製作所
- 半導体デバイス関連 インテル、STマイクロエレクトロニクス、キヤノン、サムスン電子、SCREENホールディングス、ソニー、TDK、東京エレクトロン、東芝メモリ、ニコン、日立ハイテクノロジーズ、富士通セミコンダクター、マイクロンジャパン、ルネサスエレクトロニクス、ローム
- 航空・宇宙関連 IHI、NECスペーステクノロジー、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、シンフォニアテクノロジー、ナブテスコ、日本アビオニクス、日本電気、三菱重工、三菱電機
- 光技術 大日本印刷、凸版印刷、HOYA、浜松ホトニクス、住友電気工業、横河電機、LIXIL、アズビル、NGKエレクトロデバイス、NTTエレクトロニクス、加賀電子、JVCケンウッド、日本HP、IHI検査計測、ディスコ、アルプスアルパイン、キヤノンメディカルシステムズ、ソニーIP&S、積水化学工業、シグマ光機、シャープ福山レーザー、日本ガイシ、日本板硝子
- その他 海上自衛隊、陸上自衛隊、東京ガス、東京電力ホールディングス、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道
- 電子回路基板 アドバンテスト、イースタン、イビデン、エルナー、協栄産業、京写、京セラ、キョウデン、シライ電子工業、伸光製作所、新光電気工業、住友工プリントサーキット、大昌電子、日東電工、日本シイエムケイ、日本メクトロン、パナソニック、日立化成、フジクラ、富士通インターコネクテクトロジーズ、メイコー、山下マテリアル、利昌工業

## ■ 出展料金

区分	1小間/9m <sup>2</sup>	
一般	451,000円(税込)	
一般早期*1 ※一部適用外があります。	419,100円(税込)	
会員企業*2	通常	385,000円(税込)
	早期	360,800円(税込)
	20小間以上	338,250円(税込)

\*1 対象：非会員企業(一部適用外があります。)

\*2 対象：JPCA会員/JIEP正会員・賛助会員/JARA正会員・賛助法人会員・準会員/JEP・TEP正会員

※1小間のサイズは、3m×3m=9m<sup>2</sup>です。

※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

## ■ 出展申込 (2022年1月17日(月) 10:00~より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpca-show.com)

申込開始は2022年1月17日(月) 10:00~より開始します。

出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。

専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。

出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

## ■ 申込締切

早期申込締切日	2022年2月18日(金)
早期申込締切日 ※2020年申込の会員・非会員企業	2022年3月11日(金)
最終申込締切	2022年3月11日(金)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。

※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

## ■ 取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
~3月11日(金)	小間料金の30%
3月12日(土)~4月13日(水)	小間料金の50%
4月14日(木)~5月11日(水)	小間料金の70%
5月12日(木)~	小間料金の100%

## ■ 開催までのスケジュール

1月	2月	3月	4月	6月
▲ 1月17日(金) 10時~ 出展申込受付開始	▲ 2月18日(金) 出展早期申込締切	▲ 3月11日(金) 出展最終申込締切  ▲ 3月下旬 出展マニュアルの公開	▲ 4月上旬 小間位置選択会 出展者説明会開催  ▲ 4月上旬 招待状配布 来場登録開始	6月13日(月)~14日(火) 搬入期間  6月15日(水)~17日(金) 展示会開催  ※最終日即日撤去
← 3月下旬~随時 各種提出書類期限 →				

### ●主催者による安全対策・対応方針について

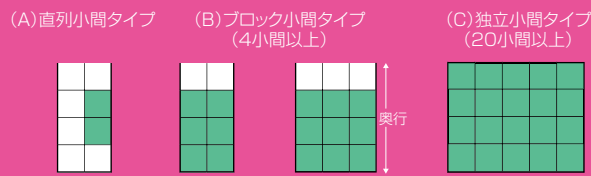
当展では参加者および主催、関係者の新型コロナウイルス感染拡大低減の対策を行い、展示会の安全性に配慮し、開催いたします。

今後は、政府や関係省庁、自治体の方針や要請を考慮し、施設との協議、連携のうえ計画を推進いたします。

### ●万が一の開催中止対応

新型コロナ(COVID-19)を要因として展示会の中止が決定した場合、出展料は100%返金します。※詳細は出展規約をご確認ください。

## ■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

## ■ 小間位置の決定

小間位置選択会(2022年4月上旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。

原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。

詳細は1月17日10:00~公開する出展申込規約をご確認ください。

## ■ 出展者サポートプログラム 有料・オプション

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

※詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。

## ■ パッケージブースプランのご案内

### ●1小間ベーシックプラン

価格：¥82,500(税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階

TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpca-show@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ